

## 【NEWS RELEASE】

2026 年 2 月 13 日

SMBC日興証券株式会社

株式会社三井住友フィナンシャルグループのデジタル・インクルージョンボンド発行支援のお知らせ

SMBC日興証券株式会社(以下「当社」)は、この度、株式会社三井住友フィナンシャルグループ(執行役社長グループ CEO:中島 達、以下三井住友フィナンシャルグループを総称して「SMBCグループ」)によるデジタル・インクルージョンボンド(以下「本債券」)の発行に向けての支援を行いましたのでお知らせいたします。本債券は、サステナビリティ関連の資金調達であり、「デジタル・インクルージョン」をテーマとした起債は、世界初の取り組みとなります。

「デジタル・インクルージョン」とは、人の属性(人種、居住地域、所得、家庭環境)などに関わらず、誰もがあらゆるデジタルテクノロジーを安全かつ自由に活用できるようにする考え方です。現在、世界人口の約33%がインターネットにアクセスできないとされる中、その主な要因として、通信インフラ不足、デバイスおよび通信料のコスト高が挙げられており、インフラ整備や技術開発等が必要とされています。この度の本債券の発行が、社会的価値創造に向けた新たな資金調達方法として、取り組みの拡充に繋がることを期待しています。

本債券で調達した資金はソーシャルファイナンスフレームワーク<sup>\*1</sup>内の Digital Inclusion ソーシャル適格プロジェクト<sup>\*2</sup>に充当されます。また、本債券は、国際資本市場協会(ICMA)が定める「ソーシャルボンド原則 2025 年版」、金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン 2021 年版」、及び World Economic Forum (WEF) による「Guidebook to Digital Inclusion Bond Financing」<sup>\*3</sup>等に準拠しています。

SMBC グループは、「環境」「DE&I・人権」「貧困・格差」「少子高齢化」「日本の再成長」を重点課題として掲げ、社会的価値の創造に向けた取り組みを推進しています。特に「貧困・格差」については、デジタル格差(Digital Divide)の解消を通じて、包摂的な社会の実現に貢献することを目指しています。

また、当社では、2018 年に日系証券会社で初めてサステナビリティ領域専門組織を発足させ、現在は、お客さまの事業・財務戦略とサステナビリティ戦略を一体で支援する体制を構築することで、高度化・多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

今後もお客さまのデジタル・インクルージョンボンドの発行支援を通じ、サステナブルファイナンスの更なる拡大と SDGs の達成に貢献してまいります。

# 【本債券の概要】

発行体	株式会社三井住友フィナンシャルグループ
通貨	米ドル建て
発行額	5 億米ドル
発行日	2026 年 2 月 12 日
償還日	2032 年 2 月 12 日 (但し、2031 年 2 月 12 日に発行体の裁量により任意償還可能)
資金使途	Digital Inclusion ソーシャル適格プロジェクト(新興国におけるデジタル・ローンを含む金融包摂、デジタル・サービスの拡張のための基本的インフラ整備、医療、教育及び職業訓練のためのプロジェクト)に対するファイナンス
利率	2031 年 2 月 11 日まで 年 4.522% (固定金利) 2031 年 2 月 12 日以降 SOFR+91bp (変動金利)
主幹事証券会社	SMBC Bank International plc Merrill Lynch International Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Natixis

- ※1 2025 年 7 月に株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行により策定されたフレームワーク。本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)の定める「ソーシャルボンド原則」、ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(APLMA)及びローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA)の定める「ソーシャルローン原則」、金融庁の定める「ソーシャルボンドガイドライン」、及び WEF の発行による「Guidebook to Digital Inclusion Bond Financing」を適用しています。
- ※2 新興国におけるデジタル・ローンを含む金融包摂、デジタル・サービスの拡張のための基本的通信インフラ整備、医療、教育および職業訓練のためのプロジェクトです。
- ※3 WEF が策定した、デジタル・インクルージョンボンドの発行に関するガイドブックです。デジタル格差の解消に資するプロジェクトへの資金供給を促進するため、デジタル・インクルージョンの定義、投資意義、フレームワークに含むべき内容、対象プロジェクト事例とそのインパクト評価指標、投資家とのエンゲージメント手法などについて具体的に言及されています。

以 上